

台灣積體電路製造股份有限公司 113 年度第 1 期無擔保普通公司債發行辦法

台灣積體電路製造股份有限公司(以下簡稱「本公司」)經呈奉 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃債字第 11300008571 號函通知申報生效發行公司債，並依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112 年 11 月 22 日證櫃債字第 1120075059 號函，取得綠色債券資格認可，訂定發行辦法如下：

- 一、債券名稱：台灣積體電路製造股份有限公司 113 年度第 1 期無擔保普通公司債。
- 二、發行總額：發行總額為新臺幣 228 億元整，依發行期限之不同分為甲類及乙類 2 種。甲類 5 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 120 億元整，乙類 10 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 108 億元整。
- 三、票面金額：新臺幣壹仟萬元整。
- 四、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
- 五、發行期間：甲類：自 113 年 3 月 15 日開始發行，至 118 年 3 月 15 日到期。
乙類：自 113 年 3 月 15 日開始發行，至 123 年 3 月 15 日到期。
- 六、票面利率：甲類：固定年利率 1.64%。
乙類：固定年利率 1.76%。
- 七、還本方式：各類券均為到期一次還本。
- 八、計付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。計息基礎依實際天數/該年度實際總日曆天數計算。本公司債付息金額每壹仟萬元計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。
- 九、擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
- 十、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
- 十一、受託人：本公司債由台北富邦商業銀行股份有限公司擔任債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並訂立受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與受託人有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
- 十二、還本付息代理機構：本公司債委託台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業。
- 十三、承銷機構：元大證券股份有限公司為主辦承銷商。
- 十四、通知方式：有關本公司債應通知債權人之事項，除法令另有規定者外，均於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)公告之。
- 十五、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。
- 十六、本公司債係為取具綠色債券資格認可之債券，所募集資金之使用範圍及相關管理或資訊揭露作業等，除有關規定外，另依據本公司所訂定之綠色債券計畫書辦理，計畫書內容請參閱本公司債公開說明書。

發行人：台灣積體電路製造股份有限公司

負責人：董事長 劉德音



中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 7 日